

7月市场洞察报告

半导体市场分析与趋势展望

洞察行情 精准决策

“DISTINCTIVE
INSIGHTS,
INFORMED
DECISION-MAKING”

序言

本报告由安芯易电子商务（深圳）有限公司推出，旨在为客户、供应商及合作伙伴提供半导体行业资讯及市场趋势预测，报告涵盖宏观动态、半导体产业动态、终端市场动态、重点产品行情等模块，助力行情洞察、精准决策。

本报告每月更新，可关注安芯易电子微信公众号，及时获取报告发布等信息。您也可以通过联系安芯易客户经理获取完整版报告。

目录

摘要..... 4

一、 宏观动态..... 5

 (一) 行业政策..... 5

 (二) 经济指数..... 7

二、 半导体产业动态..... 11

 (一) 短期影响..... 11

 (二) 中期影响..... 14

 (三) 长期影响..... 15

三、 终端市场动态..... 16

 (一) 人工智能..... 17

 (二) 新能源..... 17

 (三) 消费电子..... 18

 (四) 工业电子..... 18

 (五) 汽车电子..... 18

 (六) 通信电子..... 19

 (七) 医疗电子..... 19

四、 重点产品行情..... 20

 (一) 存储芯片..... 20

 (二) GPU..... 21

 (三) MCU..... 22

信息来源..... 24

免责声明..... 27

摘要

2025 年 7 月重点行情趋势	
宏观动态	● 美欧达成半导体贸易框架协议 关税调整成焦点 ● 美国放宽英伟达部分 AI 芯片对华出口限制 ● 美国放松 EDA 软件对华出口限制 ● 中美将举行斯德哥尔摩贸易会谈 聚焦关税等议题 ● 日韩发力半导体：巨额投资押注 AI 驱动
产业动态	● 短期影响：英伟达&AMD：美国批准 H20 GPU 与 MI308 AI 芯片对华销售，缓解中国算力短缺；美光、SK 海力士、三星：HBM 价格战与 DDR4 停产压力；博通 7 月 22 日股价下跌 3.34%，受 VMware 维护和合作伙伴计划调整等因素影响；德州仪器下调 2025 财年 Q3 营收指引，盘后股价暴跌逾 11%；台积电 Q2 净利润同比大增 61%，2nm 工艺 2025H2 量产，月产能 2026 年扩至 10 万片；意法半导体收购恩智浦传感器业务：逆周期投资与战略调整 ● 中期影响：微芯科技与台达电子签署 SiC 合作协议；瑞萨电子推出新型；650V/1200V SiC 肖特基二极管；Marvell 与台积电合作开发 3nm 以下 AI 定制 ASIC 和硅光子技术；长鑫存储：中国存储力量崛起，逐步挑战全球存储市场 ● 长期影响：SK 海力士 2025 年 Q1 DRAM 销量首超三星，发布 HBM4/HBM4E 计划；三星电子突破第六代 10nm 级 DRAM 良率门槛，计划下半年量产第六代 HBM4
终端市场	● 人工智能：英特尔宣布全球大裁员并叫停德国、波兰两座百亿级晶圆厂；OpenAI 牵手甲骨文，150 亿美元开发“星际之门”数据中心；华为云发布盘古大模型 5.5，并设 1.5 亿生态激励基金； ● 新能源：特斯拉投资 40 亿元，建设其在中国的首个电网侧储能电站；宁德时代厂中厂模式落地重庆，专为问界提供动力电池 ● 消费电子：苹果布局沙特市场，首家线下零售店明年开业；宇树科技递交上市辅导备案材料，拟冲刺“四足机器人第一股” ● 工业电子：施耐德电气北京亦庄 AI 创新实验室启用，中国是其全球唯一全业务线研发基地 ● 汽车电子：大众汽车再投 25 亿欧元，合肥基地变身“全球电动车旗舰工厂” ● 通信电子：中国电信投资 20 亿元的鄱阳湖智算中心一期落成，300P 算力即将对外服务；中国移动联合 GTI 发布全球首个 6G 开放试验装置，首批 30 余家产学研机构入驻

	● 医疗电子：捷迈邦美 1.77 亿美元收购 Monogram Technologies，加码手术机器人布局
产品行情	● 存储芯片：DRAM 价格全线冲高，DDR4 创十年最大单月涨幅 ● GPU：AI 需求驱动先进产能扩张，英伟达占据超 70%产业产能 ● MCU：新能源汽车等领域需求增长，车规级 MCU 芯片价涨缺货

一、宏观动态

（一）行业政策

● 美欧达成半导体贸易框架协议 关税调整成焦点

7 月 27 日，美欧达成里程碑式贸易框架协议，旨在稳定跨大西洋贸易关系。协议核心涉及半导体领域关税调整：欧盟多数商品入美将适用 15%基准关税（替代此前可能的更高税率），但芯片与制药行业的最终关税仍待两周后美国单独公布，政策细节暂未明确。协议明确，美欧在半导体设备、部分关键原材料领域实现零关税。作为交换，欧盟承诺在特朗普任期内完成 7500 亿美元战略采购（含芯片等），并推动欧洲企业赴美投资 6000 亿美元。此次协议缓解了跨大西洋贸易摩擦，为半导体产业带来稳定性，虽芯片领域最终关税仍存变数，但整体显现双方在关键技术领域寻求合作互惠的倾向。

● 美国放宽英伟达部分 AI 芯片对华出口限制

7 月 16 日，美国政府宣布取消部分先进 AI 芯片对华出口限制，涉及英伟达 H20 及超微 MI308 处理器。美国商务部长称此举为“对等交换”，已纳入稀土相关贸易协议。此前受限制影响，英伟达 2025 年一季度对 H20 芯片计提 45 亿美元库存减值，二季度几乎无该产品对华出口。分析预计，H20 重返中国市场后，将为英伟达数据中心业务带来可观收入，其恢复的算力对中国 AI 大模型研发亦具战略意义。此次调整体现美国在管控尖端技术出口的同时，平衡本国企业利益与稀土供应安全的考量。

● 美国放松 EDA 软件对华出口限制

7 月 3 日，美国政府宣布解除对中国出口电子设计自动化（EDA）软件的限制，此举被视为对中国稀土资源让步的回应，也是中美关系缓和的重要信号。西门子等企业已恢复对中国客户的

销售及技术支持，结束此前限制性合作。EDA 软件是半导体制造的关键工具，尤其在高端 AI 芯片、5G 芯片电路设计中不可或缺。此次限制自 2025 年 5 月实施后短时间内撤销，凸显全球技术经济的高度依存性，强硬技术管制难以持久。美欧厂商占据全球 EDA 市场主导地位，在中国市场份额超 70%。若禁令长期持续，将严重影响 Synopsys、新思科技等厂商营收。此次解禁有望推动 EDA 厂商 2025 年第三季度业绩快速回升。

- **中美将举行斯德哥尔摩贸易会谈 聚焦关税等议题**

7 月 27 日至 30 日，中美第三轮高级别经济与贸易会谈将在瑞典斯德哥尔摩举行，美国财政部长斯科特·贝森特与中国国务院副总理何立峰将出席，成为本月中下旬重要外交看点。此次会谈的核心议程之一，是协商是否延后 8 月 12 日原定的关税恢复上调计划。此外，美方提及将讨论中国产能过剩问题、中国购买伊朗与俄罗斯石油的相关行为，以及中方在乌克兰问题上的立场。中国外交部发言人郭家坤回应称，中方期待在平等、尊重和互利基础上加强合作，推动中美关系实现稳定、健康、可持续发展。

- **日韩发力半导体：巨额投资押注 AI 驱动**

日本推出“经济安全保障”战略，计划十年投入 50 万亿日元（约 3470 亿美元）提升芯片产能，涵盖下一代芯片、量子计算研发，支持 Rapidus 公司 2027 年前量产 2 纳米芯片。但合作方台积电称其日本熊本第二工厂扩建或延期，为日本自给计划添变数。韩国新政府将半导体列为战略支柱，2025 年加大芯片、清洁能源及数字基建领域公共支出，强调 AI 驱动增长。韩企在高带宽存储（HBM）市场表现突出，SK 海力士等借 AI 需求业绩亮眼；同时，韩国在 G7 等场合倡议加强全球合作，以巩固存储芯片领先地位。

(二) 经济指数

● 全球制造业 PMI 企稳至 50.3，区域分化影响半导体需求走向

2025 年 6 月全球制造业 PMI 录得 50.3，终结连续两月收缩、重返扩张区间，释放出制造业放缓或触底的信号，有望带动通用型半导体元件订单逐步回升。

但区域复苏势头差异显著：亚洲市场中，中国 PMI 49.7、韩国 PMI 48.7，持续收缩，凸显电子制造重镇压力；日本 PMI 50.1，重返扩张，印度 PMI 58.4，保持高位强势增长。发达市场方面，美洲 PMI 49.0，收缩放缓；欧洲 PMI 50.5，回升至扩张区间，显露出积极转变。

这种分化为半导体需求带来复杂前景：日本、欧元区回暖利好模拟 IC、微控制器等通用芯片，但中、韩等主要市场收缩意味着全面复苏仍存阻力。对厂商而言，需聚焦印度等快速增长市场及欧美温和复苏机遇，同时警惕亚洲制造基地的下行风险，策略上需“因地制宜、因品类制宜”。

全球各地区制造业 PMI

时间	全球	中国	日本	韩国	印度	美国	欧元区
2024-01	50.00	49.20	48.00	51.20	56.50	49.10	46.60
2024-02	50.30	49.10	47.20	50.70	56.90	47.80	46.50
2024-03	50.60	50.80	48.20	49.80	59.10	50.30	46.10
2024-04	50.30	50.40	49.60	49.40	58.80	49.20	45.70
2024-05	50.90	49.50	50.40	51.60	57.50	48.70	47.30
2024-06	49.50	49.50	50.00	52.00	58.30	51.70	45.60
2024-07	49.80	49.40	49.10	51.40	58.10	46.80	45.80
2024-08	48.90	49.10	49.80	51.90	57.50	47.20	45.60
2024-09	48.80	49.80	49.70	48.30	56.50	47.20	45.00
2024-10	48.80	50.10	49.80	48.30	57.50	46.50	46.00
2024-11	50.00	50.30	49.00	50.60	56.50	48.40	45.20
2024-12	49.60	50.10	49.60	49.00	56.40	49.20	45.10
2025-1	50.10	49.10	48.70	50.30	57.70	50.90	46.60
2025-2	50.60	50.20	49.00	49.90	56.30	50.30	47.60
2025-3	50.30	50.50	48.40	49.10	58.10	49.00	48.60
2025-4	49.80	49.00	48.70	47.50	58.20	48.70	49.00
2025-5	49.60	49.50	49.40	47.70	57.60	48.50	49.50
2025-6	50.30	49.70	50.10	48.70	58.40	49.00	50.50

数据来源：Wind

● 5月全球半导体销售额创新高，美洲与亚太地区领涨

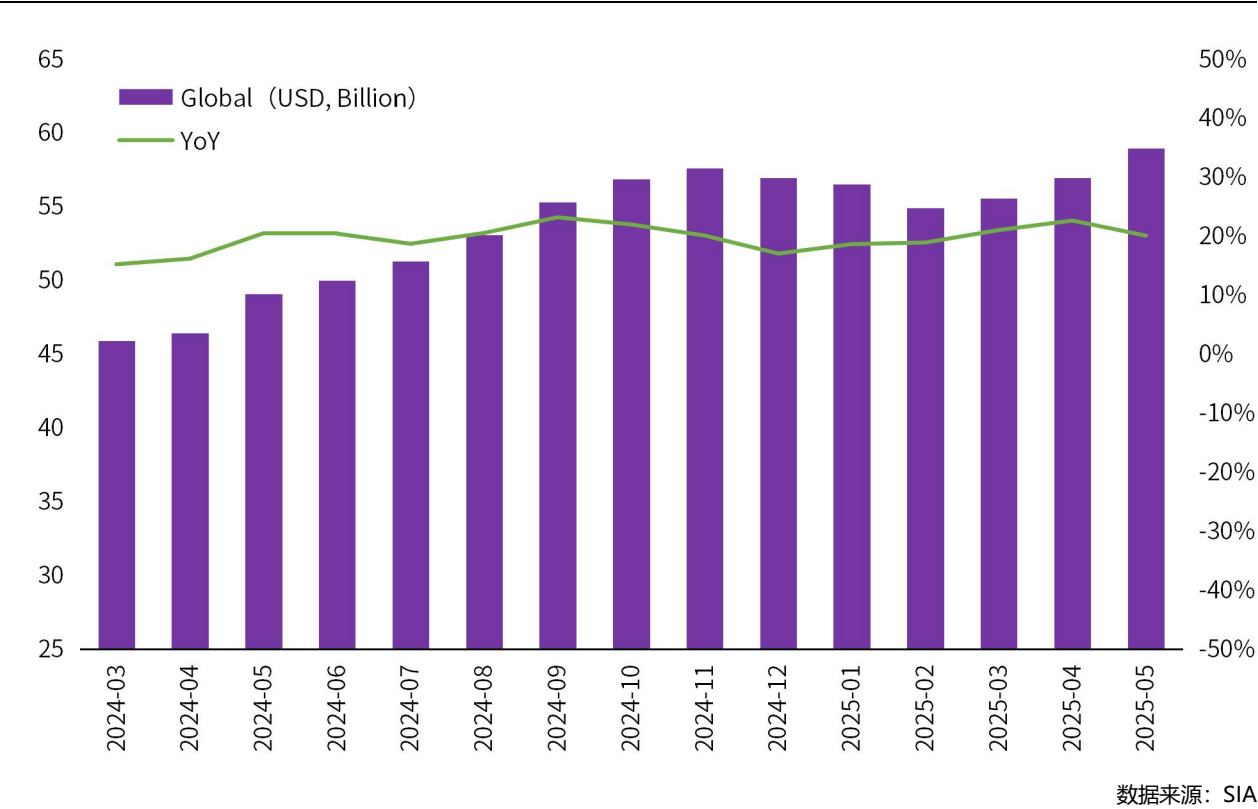
2025年5月，全球半导体销售额达589.8亿美元，创下历史单月新高，同比增长20.1%，连续多月保持双位数扩张，凸显全球半导体市场需求的强劲与广泛。

从区域表现来看，各市场均呈增长态势，且分化明显：美洲地区同比大增45.2%，成为增长最快的区域；亚太及其他地区同比增长30.5%，紧随其后；中国以20.5%的同比增速保持稳健增长；日本和欧洲则分别录得4.5%、4.1%的温和增长。

环比数据同样亮眼，多数区域延续增长势头：亚太及其他地区环比上升6.0%，表现领先；中国环比增长5.4%，增速稳健；欧洲环比增长4.0%，回升态势明显；美洲和日本分别微增0.5%、0.2%，保持平稳。

这一销售数据反映出全球半导体关键元件需求环境健康，尤其在美洲、亚太等主要市场的带动下，整体需求持续向好。随着终端应用景气度回升及企业备货意愿增强，预计将对半导体产品的交期和价格产生积极影响。对电子制造业的采购及供应链决策者而言，需提前布局采购策略，强化供应链弹性，以应对市场机遇与潜在波动。

全球半导体销售额（十亿美元）



● 美国 10 年期国债收益率 6-7 月高位震荡，影响半导体产业

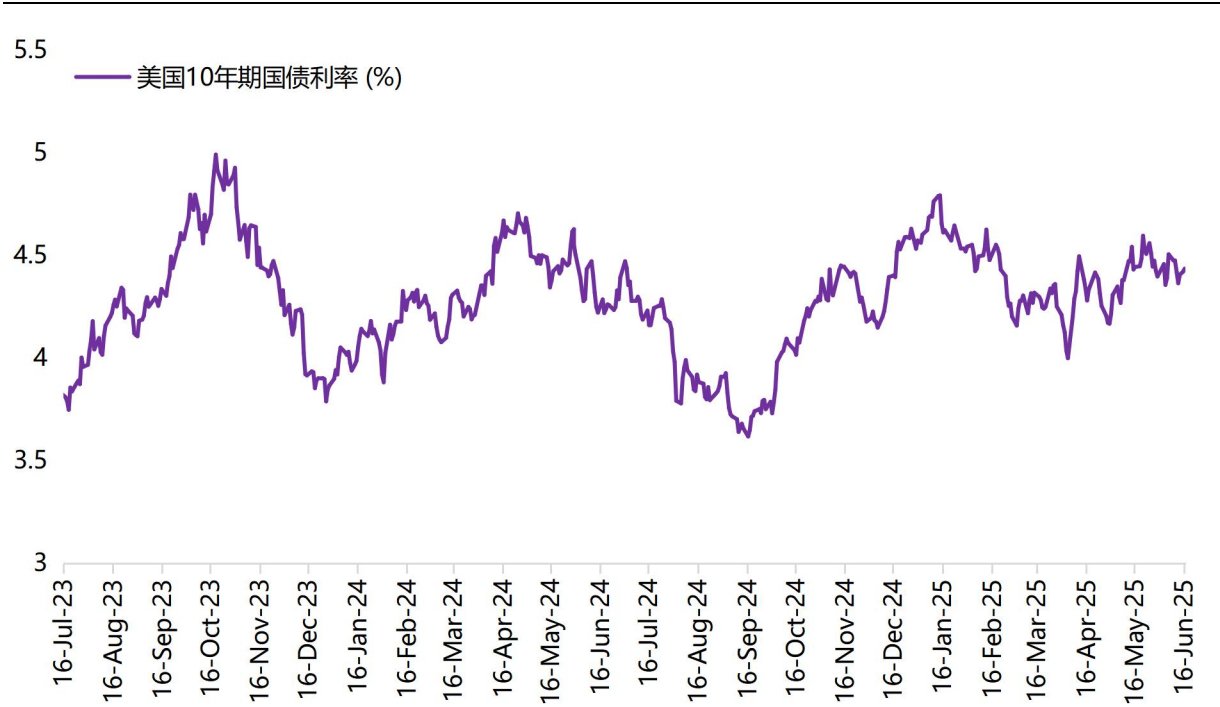
2025 年 6 月至 7 月，美国 10 年期国债收益率持续在高位震荡。继 5 月中旬触及 4.7%的阶段高点后，6 月多数时间在 4.1%-4.5%区间波动；6 月底至 7 月初短暂回落至 4.1%左右，7 月中旬又反弹回升，7 月 22 日升至 4.4%。

从周期来看，当前收益率仍显著高于 2024 年初（3.8%）和年中（3.7%）的低点，虽未回到 2023 年末近 5%的峰值，但长期维持在 4%以上，反映出市场对通胀、经济增长及美联储货币政策的持续预期。这种波动体现了市场正依据最新经济数据和央行动态调整宏观判断。

对半导体与电子制造业而言，高位收益率的影响值得关注：1) 融资成本上升：高基准利率推高企业借贷成本，可能抑制晶圆厂建设、设备投资等半导体行业的高资本支出计划；2) 资本配置偏移：固定收益类资产吸引力提升，或压制科技股估值，间接影响半导体板块的资本流入；3) 需求与成本的平衡：高收益率一定程度反映经济韧性，若增长稳定或支撑电子终端需求，但融资趋紧仍是产业决策需考量的变量。

半导体厂商及电子制造企业需密切跟踪利率趋势，在高利率环境下优化资本结构与现金流管理，以平衡投资与风险，保持战略灵活性。

美国 10 年期国债利率(%)



数据来源: Investing

● 费城半导体指数 6-7 月持续大涨，彰显市场信心

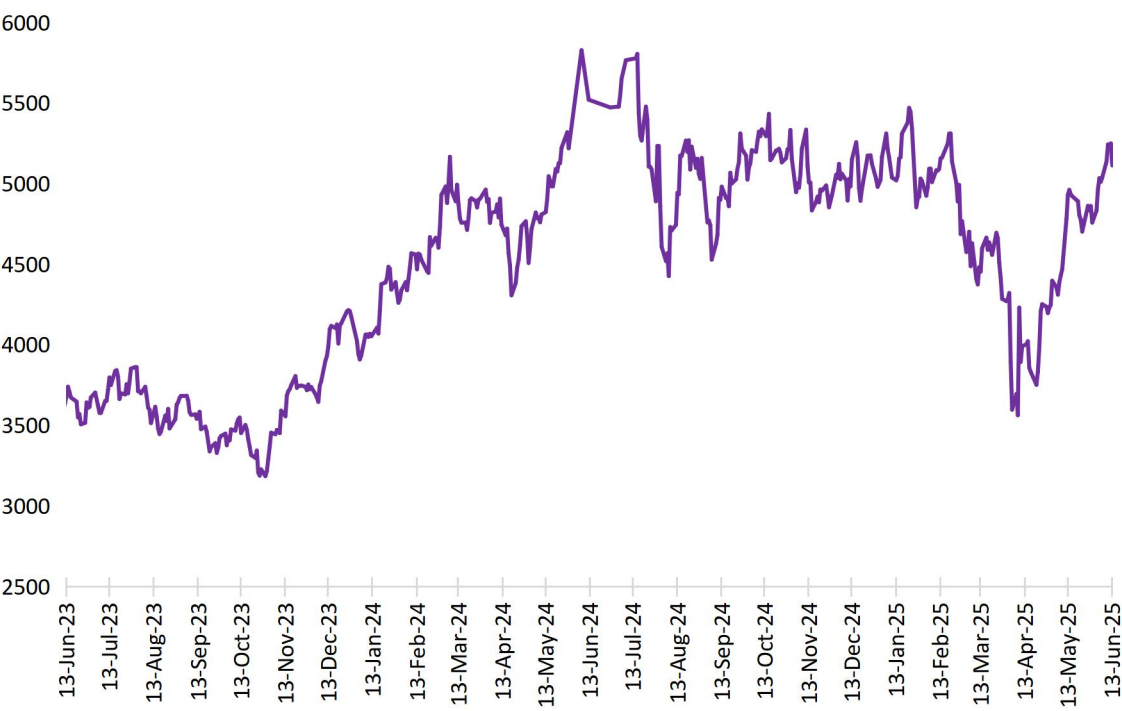
作为全球半导体产业的核心风向标，费城半导体指数（SOX）在 2025 年 6 月至 7 月中旬延续强劲涨势，彰显资本市场对行业的乐观预期。数据显示，5 月指数平均收于 4690.77 点，6 月便强势攀升至月均 5208.91 点；进入 7 月后涨势未歇，截至 7 月 14 日，月均值进一步升至 5629.49 点，期间多次刷新历史新高。

从具体走势看，6 月指数从 5000 点下方持续上行，月底成功突破 5500 点；7 月再接再厉，突破 5600 点整数关口，涨势动能清晰可见。这一表现与 5 月全球半导体销售额同比大增 20.1% 的亮眼数据形成呼应，行业景气度与投资者信心形成正向循环。

指数持续上涨的背后，是多重结构性驱动力的共同作用：AI 加速计算、云端数据中心建设需求爆发，叠加高阶汽车电子市场的快速扩张，共同推高了对高性能芯片的需求，成为板块估值上行的核心推力。

对行业而言，SOX 指数的强势不仅是市场信心的直观体现，更将为半导体企业创造更有利的融资环境，助力其推进晶圆厂扩建、设备升级与技术研发等长期投资。而对电子制造商来说，这也意味着芯片供应商的产能与创新能力将得到强化，为下游复杂元件需求提供更稳定的支撑。

费城半导体指数(SOX)



数据来源：MacroMicro

二、半导体产业动态

半导体产业动态概览			
维度	厂商	经营动态	解读
短期影响	英伟达/超威半导体 NVIDIA/AMD	美国批准 H20 GPU 与 MI308 AI 芯片对华销售，缓解中国算力短缺	美国放宽对华出口限制，英伟达与 AMD 的 AI 芯片重新进入中国市场，短期内有助于缓解中国 AI 算力缺口，但国产替代趋势持续增长。
	美光/三星/SK 海力士 Micron/Samsung/SK hynix	HBM 价格战与 DDR4 停产压力	美光受 HBM 价格战影响，股价跌至近期新低。SK 海力士和三星获得更多定价权，压力加大。DDR4 停产导致现货价格飙升，交期延长，市场不确定性加剧。
	博通 Broadcom	7 月 22 日股价下跌 3.34%，受 VMware 维护和合作伙伴计划调整等因素影响	VMware 服务维护问题和新合作伙伴计划带来的不确定性短期扰动市场情绪，但公司 AI 专用芯片业务强劲。
	德州仪器 TI	下调 2025 财年 Q3 营收指引，盘后股价暴跌逾 11%	汽车及工业需求未如预期快速恢复，导致业绩指引偏低，投资者担忧需求持续性。
	台积电 TSMC	Q2 净利润同比大增 61%，2nm 工艺 2025H2 量产，月产能2026年扩至10万片	2025 年下半年启动 2nm 工艺量产，预计到 2026 年扩产至 10 万片/月，助力 AI 和 HPC 市场增长，尽管地缘政治和竞争压力依然存在。
	意法半导体/恩智浦 STMicroelectronics /NXP	意法半导体收购恩智浦传感器业务：逆周期投资与战略调整	2025 年，意法半导体以 9.5 亿美元收购恩智浦传感器业务，战略聚焦于提升汽车及工业领域的 MEMS 传感器与压力传感器业务。该交易预计 2026 年上半年完成，进一步增强其在汽车安全及传感器技术领域的竞争力。
中期影响	微芯科技 Microchip	与台达电子签署 SiC 碳化硅功率管理方案合作协议	联合开发碳化硅功率器件，面向电动汽车与工业电源等市场，加快新型电源解决方案布局。
	瑞萨电子 Renesas	推出新型 650V/1200V SiC 肖特基二极管	扩充高压 SiC 肖特基器件组合，提升高频、高效能电源设计的性能，增强工业电源市场竞争力。
	美满电子科技 Marvell	与台积电合作开发 3nm 以下 AI 定制 ASIC 和硅光子技术	长期布局 AI 定制芯片与高速互联基础设施，但需面对英伟达和 AMD 等核心竞争者的挑战。
	长鑫存储 CXMT	中国存储力量崛起，逐步挑战全球存储市场	通过技术突破和产能扩展，长鑫存储迅速在全球存储市场崭露头角，特别是在 DDR4 市场的价格变化中扮演重要角色。

长期影响	SK 海力士 SK Hynix	SK 海力士 2025 年 Q1 DRAM 销量首超三星，发布 HBM4/HBM4E 计划	借力 AI 需求和 HBM 技术领先地位抢占市场份额，持续强化在高带宽存储领域的行业领先优势。
	三星电子 Samsung	突破第六代 10nm 级 DRAM 良率门槛，计划下半年量产第六代 HBM4	通过先进 DRAM 制程提速 HBM4 研发，力图缩小与对手差距，提升其在 AI 高带宽内存市场中的地位。

(一) 短期影响

● 英伟达、AMD：美国放宽 AI 芯片出口限制，缓解中国 AI 算力短缺

2025 年 7 月，美国政府批准英伟达 H20 GPU 与 AMD MI308 AI 芯片对华销售，标志着中美半导体贸易政策的局部缓和。短期内，这一政策变动将有效缓解中国 AI 服务器厂商的算力短缺问题，尤其是在 AI 推理与训练领域。然而，国产替代趋势仍在加速推进，华为昇腾与寒武纪等国产芯片的技术不断成熟，未来中国市场对外部 AI 芯片的依赖可能逐渐降低。TrendForce 预测，中国 AI 芯片的外购比例将回升至 49%，但仍低于禁令前的水平。长期来看，国产 AI 芯片的自主化进程不可逆转，且可能进一步影响国际 AI 芯片市场的格局

● 美光、SK 海力士、三星：HBM 价格战与 DDR4 停产压力

2025 年 7 月，随着 HBM 价格战的加剧，美光科技的股价创下近期新低。SK 海力士和三星等竞争对手在市场上获得了更多定价权，导致美光面临利润压力，特别是在 2026 年 HBM 价格下滑预期的影响下。除此之外，美光还面临 DDR4 停产带来的巨大压力。2025 年 7 月，DDR4 现货价格暴涨至 5 美元，较 4 月上涨 200%，供需失衡导致工控和嵌入式领域的交期延长至 40 周。短期内，价格波动和供应链紧张加剧了市场的不确定性，投资者情绪低迷，股价承压。美光需要通过技术创新、成本控制和市场调整等方式应对这场价格战，以稳定其在存储市场的地位。

● 博通 7 月 22 日股价下跌 3.34%，受 VMware 维护和合作伙伴计划调整等因素影响

2025 年 7 月 22 日，博通(Broadcom)股价下跌 3.34%。原因是近期博通在 VMware Tanzu CloudHealth 服务维护方面遇到问题，并宣布将于 2025 年 10 月底实施新的合

作伙伴计划，包括减少合作伙伴数量及终止部分白标项目。这些举措引发市场对博通未来合作关系的担忧，从而导致短期股价震荡。然而，分析师指出，尽管面临暂时的不确定性，博通在人工智能定制 ASIC 芯片领域处于领先地位，为谷歌、亚马逊等客户提供芯片，长期来看潜力巨大。总体而言，博通此次回调主要是市场对其战略调整的短期反应，但公司强大的 AI 芯片业务和市场地位意味着股价回暖仍有支撑。

- **德州仪器下调 2025 财年 Q3 营收指引，盘后股价暴跌逾 11%**

德州仪器 (Texas Instruments, TI) 7 月 22 日发布第三季度财报指引，预期营收 44.5 亿美元至 48 亿美元。尽管这一区间包括分析师预估的 45.7 亿美元，但未全面满足市场乐观预期。业绩展望令投资者担忧需求复苏未如期到来，尤其汽车和工业客户的芯片需求仍处于调整期。受此影响，TI 股价盘后交易中下跌逾 11%。TI 首席执行官也提到“汽车业务尚未恢复”，反映汽车市场疲软对公司营收造成拖累。综合分析，TI 短期营收不及乐观预期导致股价承压，但从长期看，公司仍受益于模拟与工业芯片的结构性需求，只是需要渡过当前周期性波动。

- **台积电 Q2 净利润同比大增 61%，2nm 工艺 2025H2 量产，月产能 2026 年扩至 10 万片**

台积电在 2025 年 Q2 的净利润同比增长 61%，7nm 以下制程贡献了 74% 的营收。2025 年下半年，2nm 工艺将开始量产，并计划到 2026 年扩产至 10 万片/月，进一步巩固其在 AI 与 HPC 领域的领导地位。尽管短期内台积电仍占据优势地位，但随着三星和英特尔的竞争加剧，以及潜在的地缘政治风险，台积电的市场主导地位面临一定压力。

- **意法半导体收购恩智浦传感器业务：逆周期投资与战略调整**

2025 年，意法半导体 (STMicroelectronics) 宣布以 9.5 亿美元收购恩智浦 (NXP) 传感器业务，预计交易将在 2026 年上半年完成。此项收购旨在提升意法半导体在汽车和工业传感器领域的市场地位，特别是在 MEMS 惯性传感器和压力传感器的关键市场。该业务将被整合进意法半导体的模拟、MEMS 和传感器部门，进一步强化其在汽车安全系统（如安全气囊、车辆动力学控制、胎压监测）及工业应用（如压力传感器和加速度计）中的技术能力。

恩智浦此举基于其长期战略调整，认为该传感器业务更契合意法半导体的技术平台、制造布局和市场需求。根据市场数据显示，恩智浦该业务在 2024 年创造了约 3 亿美元的营收。尽管意法半导体的整体营收面临压力，其在传感器领域实现的两位数增长证明

了这一收购将进一步增强其在汽车及工业市场中的领导地位，并为公司在未来高增长领域提供新的动力。

（二）中期影响

● 微芯科技与台达电子签署 SiC 合作协议

2025 年 7 月，微芯科技（Microchip）宣布与台湾台达电子（Delta Electronics）达成合作，共同开发碳化硅（SiC）功率器件解决方案。双方将利用微芯的 mSiC™技术与台达的电源方案，面向电动汽车、可再生能源等领域提升 SiC 功率管理效率。这一合作加速了碳化硅技术的应用落地，对公司中期战略意义重大。解读上看，随着新能源汽车和电力电子需求增长，SiC 器件市场潜力巨大。微芯通过与电源行业龙头合作，能快速拓展 SiC 产品线及客户群，有望在未来几年内实现业绩增长。

● 瑞萨电子推出新型 650V/1200V SiC 肖特基二极管

瑞萨电子推出了新型 650V 和 1200V 第三代 SiC 肖特基二极管，这些器件在高频硬开关电路中提高效率，广泛应用于电力电子、工业驱动和新能源汽车市场。此举将帮助瑞萨进一步巩固其在高压功率半导体市场的竞争力，尤其在日益增长的电动汽车市场中占据一席之地。

● Marvell 与台积电合作开发 3nm 以下 AI 定制 ASIC 和硅光子技术

Marvell 正与 TSMC 合作开发 3nm 以下工艺的 AI 定制 ASIC，并探索集成硅光子技术，以提升数据中心与光通信基础设施效率和性能。尽管这标志着 Marvell 在高速互联和 AI 计算芯片上的技术前瞻性布局，其仍需面对英伟达和 AMD 在定制 AI 芯片市场的激烈竞争。随着市场对 AI 基础设施的需求持续增长，Marvell 的这一战略将决定其在未来高性能云计算生态系统中的地位

● 长鑫存储：中国存储力量崛起，逐步挑战全球存储市场

长鑫存储自成立以来，持续突破技术瓶颈，尤其在 19nm 工艺的进步与大规模产能提升上，逐渐成为全球存储市场的重要力量。2019 年量产的 DDR4 内存与 2025 年推出的 LPDDR5 芯片，标志着长鑫在存储市场的崛起，直接影响了全球价格体系。在国际巨头宣布停产 DDR4 后，长鑫存储凭借技术优势与产能扩张，迅速填补了市场空缺，将全球市场份额从 6%提升至 8%。其在低端市场的主导地位也进一步巩固了其全球竞

争力。随着技术不断提升，长鑫存储预计将在未来几年内，继续提升产能，并为全球存储市场带来更多的竞争力。预计 2025 年后，长鑫将通过持续创新及资金投入，在 DRAM、LPDDR 等领域进一步挑战市场主导地位，为全球存储市场带来深远影响。

（三）长期影响

- **SK 海力士 2025 年 Q1 DRAM 销量首超三星，发布 HBM4/HBM4E 计划**

Counterpoint Research 数据显示，2025 年第一季度 SK 海力士以 36% 的 DRAM 市场份额首次超过三星的 34%，成为全球 DRAM 市场新一代领军者。这一成就主要归功于其领先的高频宽内存（HBM）技术。报道称，SK 海力士目前在 HBM 领域市占高达 70%，并向英伟达等 AI 巨头供应最新的第 5 代 HBM3E 芯片。展望未来，SK 海力士将于 2025 年推出第 6 代 HBM4（含 12 层堆栈）和第 7 代 HBM4E，并计划下半年量产 12 层 HBM4。长期来看，SK 海力士正通过持续技术投入和快速量产加固其在 AI 存储市场的领导地位。

- **三星电子突破第六代 10nm 级 DRAM 良率门槛，计划下半年量产第六代 HBM4**

据 TechNews 报道，三星电子近期成功将 10nm 级第六代 DRAM（代号“1c”工艺）良率提升至 50% 以上，并计划导入第 6 代 HBM4 内存，下半年启动量产。1c 工艺节点相当于 11-12nm，比现有主流 DRAM 更高密度、功耗更低，适合叠层更多的 HBM4 芯片。报道指出，三星此前曾向 AMD 供应 HBM3E，却未通过英伟达的测试，市场占有率受到挑战。为扭转局面，三星加强 1c 工艺研发，引入自研 4nm 制程制造逻辑芯片，并计划提供面向不同应用场景的“定制 HBM4”解决方案。综合来看，三星此举显示其正加速对高端存储的布局，若顺利推进，将助其在 AI 加速器市场重塑竞争优势。

三、终端市场动态

终端市场动态概览			
类别	版块	厂商	6-7 月市场动态
人工智能	AI 芯片	英特尔 Intel	英特尔宣布全球大裁员并叫停德国、波兰两座百亿级晶圆厂
		OpenAI	牵手甲骨文，150 亿美元开发“星际之门”数据中心
	云计算与大数据	华为云 HUAWEI	发布盘古大模型 5.5，并设 1.5 亿生态激励基金
新能源	光伏、储能	特斯拉 Tesla	投资 40 亿元，建设其在中国的首个电网侧储能电站
	新能源汽车	宁德时代&问界 CATL&AITO	宁德时代厂中厂模式落地重庆，专为问界提供动力电池
消费电子	智能手机	苹果 Apple Inc	布局沙特市场，首家线下零售店明年将开业
	机器人	宇树科技 Unitree	递交上市辅导备案材料，拟冲刺“四足机器人第一股”
工业电子	工业自动化与控制	施耐德电气 Schneider	北京亦庄 AI 创新实验室启用，中国是其全球唯一全业务线研发基地
汽车电子	汽车产业链	大众汽车 Volkswagen	再投 25 亿欧元，合肥基地变身“全球电动车旗舰工厂”
通信电子	通信网络、光纤	中国电信 China Telecom	投资 20 亿元的鄱阳湖智算中心一期落成，300P 算力即将对外服务
		中国移动 China Mobile	联合 GTI 发布全球首个 6G 开放试验装置，首批 30 余家产学研机构入驻
医疗电子	医疗影像设备	捷迈邦美 Zimmer Biomet	1.77 亿美元收购 Monogram Technologies，加码手术机器人布局

（一）人工智能

- **英特尔宣布全球大裁员并叫停德国、波兰两座百亿级晶圆厂**

7月24日，英特尔新任CEO陈立武宣布：因二季度亏损29亿美元，公司正式砍掉德国、波兰两座百亿级晶圆厂，并同步启动全球裁员，年底前员工数从9.6万缩至7.5万，旨在实现2025年运营费用降至170亿美元的目标。同时，英特尔放缓俄亥俄州工厂建设，集中资源押注18A制程与AI芯片，直言“不再开空白支票”。

- **OpenAI 牵手甲骨文，150 亿美元开发“星际之门”数据中心**

7月22日，OpenAI宣布，与甲骨文公司达成协议，将共同在美国开发4.5GW新增“星际之门”数据中心算力。据介绍，结合德州阿比林市在建的首个“星际之门”基地，此次与甲骨文的合作将使OpenAI开发中的AI数据中心总容量突破5GW，可支持超200万枚芯片运行。

- **华为云发布盘古大模型 5.5，并设 1.5 亿生态激励基金**

6月20日，华为云发布“盘古大模型 5.5”，覆盖五大核心领域，推理效率提升八倍，面向金融、制造、政务等场景开放公测。为进一步壮大业务合作生态体系，华为云还发布了一项总额达1.5亿元人民币（约合2100万美元）的生态激励计划，聚焦昇腾AI服务、Gauss DB数据库等四大核心方向，加大对业务合作伙伴的专项支持。

（二）新能源

- **特斯拉投资 40 亿元，建设其在中国的首个电网侧储能电站**

6月20日，特斯拉与上海市临港新片区管委会正式签约，总投资40亿元（约5.57亿美元）建设其在中国大陆的首个电网侧吉瓦级储能电站——临港构网型零碳能源国际合作示范中心。项目采用特斯拉上海超级储能工厂生产的Megapack系统，一期规划300 MWh，预计2025年内并网，投运后将直接参与华东电网调峰、调频及现货电力交易，年均可为36万户家庭提供1小时应急供电。

- **宁德时代厂中厂模式落地重庆，专为问界提供动力电池**

6月30日，宁德时代在赛力斯超级工厂的两条CTP 2.0高端电池包产线正式投产。这是宁德时代在重庆布局的首个基地，并首次采用“厂中厂”的合作模式，即：产线直

接嵌入整车工厂，实现 20 分钟供应链响应。该基地专为问界全系车型提供动力电池，目前已累计配套超 70 万辆，未来双方还将在新品研发、新材料应用及零碳智造等领域进行深度合作。

（三）消费电子

- **苹果布局沙特市场，首家线下零售店明年开业**

7 月 21 日，科技媒体 MacRumors 报道，苹果公司正式在沙特阿拉伯开设官方线上商店。沙特当地消费者可直接购买 iPhone、iPad、Mac 等全系产品，并首次获得阿拉伯语官方支持与服务。此外，苹果还计划自 2026 年起在沙特阿拉伯开设多家零售店，位于首都利雅得郊区的迪里耶赫首家线下旗舰店将于 2026 年开业。

- **宇树科技递交上市辅导备案材料，拟冲刺“四足机器人第一股”**

7 月 18 日，杭州宇树科技有限公司向浙江证监局提交上市辅导备案材料，正式启动 IPO 进程，目标成为国内“四足机器人第一股”。作为全球知名的四足机器人研发企业，宇树科技 2024 年营收超 10 亿元，连续 5 年实现盈利。公司计划登陆科创板，若进程顺利，将成为 A 股首家以四足机器人为核心业务的上市公司。

（四）工业电子

- **施耐德电气北京亦庄 AI 创新实验室启用，中国是其全球唯一全业务线研发基地**

7 月 7 日，施耐德电气在北京亦庄宣布其 AI 创新实验室正式启用。该实验室配备 350 余名 AI 专家，聚焦工业自动化、智慧楼宇、绿色数据中心等场景的 AI 算法，目标将 AI 研发周期缩短 30%、方案验证成本降低 40%。施耐德电气执行副总裁、中国及东亚区总裁尹正表示，中国已成为施耐德电气全球唯一拥有全业务线研发能力的国家，北京亦庄 AI 创新实验室的落成，将进一步强化其以中国创新反哺全球的能力。

（五）汽车电子

- **大众汽车再投 25 亿欧元，合肥基地变身“全球电动车旗舰工厂”**

7 月 16 日，大众汽车集团宣布追加 25 亿欧元投资，用于扩建其位于安徽合肥的生产基地。项目聚焦 MEB+ 平台、CMP 平台及下一代智能网联电动车，计划 2026 年起使合肥年产能提升至 100 万辆，并同步建设动力电池、电驱系统及软件研发中心。大

众汽车表示，合肥将成为集团除德国狼堡外最大的全球电动车制造与出口枢纽，首批新车型将在 2027 年投向欧洲及东南亚市场。

（六）通信电子

- **中国电信投资 20 亿元的鄱阳湖智算中心一期落成，300P 算力即将对外服务**

7 月 8 日，中国电信宣布江西省首个省级智算枢纽——鄱阳湖智算中心一期 300P 算力设施全面建成，计划 7 月中旬正式对外提供服务。项目总投资 20 亿元，采用“1 个智能云中心+1 个算力共享平台+1 个 AI 展示中心+N 个行业场景”架构，部署 2960 个标准机柜，未来将形成 2500P 算力规模。中心同步上线江西省首个算力调度平台“息壤”，已为九江学院、市一医院、市生态环境局及多家 AI 企业签约提供智算服务。

- **中国移动联合 GTI 发布全球首个 6G 开放试验装置，首批 30 余家产学研机构入驻**

7 月 10 日，在瑞士日内瓦举行的 GTI 国际论坛上，中国移动联合 GTI，携手中关村泛联院、中信科移动、vivo 等 30 余家产学研伙伴正式发布“6G 开放试验装置”（6G Open Testbed），并宣布首批机构正式入驻。该装置由网络仿真平台、原型系统与外场测试环境三大板块构成，可一站式验证超大规模 MIMO、通感算一体、网络 AI 及具身智能机器人等 6G 关键技术，标志着中国 6G 研发由实验室走向全球开放试验阶段，将为国际标准制定与产业生态建设提供公共底座。

（七）医疗电子

- **捷迈邦美 1.77 亿美元收购 Monogram Technologies，加码手术机器人布局**

7 月 14 日，全球骨科医疗巨头捷迈邦美宣布，将以约 1.77 亿美元收购机器人技术公司 Monogram Technologies，该公司专注于开发半自动及全自动机器人技术，其基于 CT 影像的半自动、人工智能导航全膝关节置换机器人系统，今年 3 月刚获得美国 FDA 认证。捷迈邦美将把 Monogram 的手术产品纳入自身机器人业务组合，计划在 2027 年前推出全自动手术机器人及膝关节假体置换等更多应用，进一步拓展其机器人平台的业务范围。

四、重点产品行情

(一) 存储芯片

2025 年 6-7 月存储芯片重点产品行情一览

产品	代表型号	价格趋势	交期（周）	供需状态
DDR4	8GB	上涨	未明确	紧张
DDR5	16GB	上涨	未明确	平衡
NAND Flash	128GB	上涨	6-10	紧张
eMMC	32GB	上涨	8-12	偏紧
HBM 高带宽内存	HBM3E	上涨	52+	长期紧张

数据来源：EET China、TrendForce、AnandTech、行业现货报价

● DRAM 价格全线冲高，DDR4 创十年最大单月涨幅

1) 产品动态

- **DDR4:** 三大原厂“弃旧迎新”，减产节奏超预期。三星已于 2025 年 6 月停止接受 DDR4 芯片订单，计划到 12 月中旬完成最后模块出货；SK 海力士预计 10 月停接订单，2026 年 4 月结束出货；美光 6 月初向客户发出停产通知，2026 年一季度逐步停止供货。6 月 DDR4 部分现货产品单月涨超 100%。
- **DDR5:** 三大厂商产能转向 DDR5，需求受新平台（如 AI PC/服务器）推动稳步上升，价格温和上涨。
- **NAND Flash:** 原厂联合减产，预计 2025 年三季度合约价上涨 5-10%。交期延长至 6-10 周，渠道库存持续消耗。
- **eMMC:** 小容量(32GB 及以下)因 MLC 停产供应紧张,价格普涨;大容量(64GB+)供应相对稳定，交期维持在 8-12 周。
- **HBM:** SK 海力士 HBM3E 产能售罄至 2025 年底，美光加速扩产。交期超 52 周，

价格年涨幅达 5-10%，AI 芯片需求为主要驱动力。

2) 市场趋势

- **涨价主导：**全品类价格普涨，DDR4（+50% YoY）、HBM（+10% YoY）领跑。
- **供应瓶颈：**DRAM 产能转向 HBM/DDR5，传统 DDR4、NAND 小容量成短缺重灾区。
- **国产突破：**长鑫存储 DDR4 份额提升，但三巨头仍垄断 DRAM/NAND 市场(>90%)。

(二) GPU

2025 年 6-7 月 GPU 重点产品行情一览

产品	代表型号	价格趋势	交期（周）	供需状态
消费级	RTX 5090	上涨	4-6	紧缺
AI 训练卡	H100 SXM5	持平	20-26	紧缺
	AMD MI300X	下降	12-16	缓解
边缘推理	A100 PCIe 80GB	上涨	8-12	紧缺
国产替代	摩尔线程 MTT S80	下降	2-4	平衡

数据来源：Jon Peddie Research、DigiTimes、供应链渠道调研

● AI 需求驱动先进产能扩张，英伟达占据超 70%产业产能

1) 产品动态

- **AI 训练卡：**英伟达 H100 交期长达半年，亚马逊/Meta 万卡级订单挤压中小企业供应；AMD MI300X 降价抢占市场，但软件生态差距仍限制份额提升。
- **消费级 GPU：**RTX 5090：能效比提升 50%，但台积电 CoWoS 封装产能不足导致

现货溢价约 40%。

- **边缘与国产化:**边缘推理卡 A100 成“硬通货”,二手市场价格两年内逆势上涨 120%;
国产 GPU: 摩尔线程/壁仞等厂商在政企市场占比升至 15%, 但游戏与 AI 场景仍处劣势。

2) 市场趋势

- **英伟达霸权 vs AMD 突围:** 英伟达 H100 持续统治, 全球 AI 基建扩张推动需求爆发, H100 整机价稳居 3.5 万美元高位; AMD 降价抢滩: MI300X 整机价降至 2.8 万美元, 开放 ROCm 生态吸引长尾客户, 但软件兼容性差距仍限制份额突破。
- **供应链博弈: 产能、制裁与生态:** 产能分配失衡, 台积电 CoWoS 封装月产能仅 40 万片, 其中 70%已被英伟达 GB200/H200 锁定, AMD MI350 仅分到 8%。SK 海力士 HBM3e 优先供应英伟达, AMD 交期被动延长 30%。

(三) MCU

2025 年 6-7 月 MCU 重点产品行情一览

产品	代表型号	价格趋势	交期 (周)	供需状态
8 位基础 MCU	恩智浦 S9S08PA	上涨	18-22	稳定
	瑞萨 RL78/F14			
32 位通用 MCU	意法半导体 STM32A	上涨	24-30	紧缺
	德州仪器 TMS570			
车规 MCU	英飞凌 TC4xx	上涨	30-52	紧缺
	恩智浦 S32K3			
国产替代 MCU	芯驰 E3 系列	稳定	12-18	稳定
	琪埔维 XL6600			

数据来源: Strategy Analytics、Automotive Electronics Council、供应链调研

- **新能源汽车等领域需求增长，车规级 MCU 芯片价涨缺货**

1) 产品动态

- **8 位 MCU:** 价格持续走低, 部分通用型号因供过于求, 价格较 6 月初下降 5%-8%。交期情况较为稳定, 部分分销商为清理库存, 甚至出现现货供应。
- **32 位 MCU:** 受车规与工控需求持续推高 32 位 MCU 价格, 预计 2025 年三季度仍有 3-5 %上行空间。
- **车规级 MCU:** 6 月国内新能源汽车销量 88.7 万辆, 同比增加 35%, 车规 MCU 订单环比增加 20 %; 车规级 MCU 受需求上升影响, 现货价格月环比上涨 10%-15%, 恩智浦、英飞凌等厂商的车规级产品价格稳中有升。交期较长, 普遍在 40-52 周。
- **国产替代 MCU:** 为抢占市场份额, 国产替代 MCU 价格较进口同类产品低 10%-20%, 6-7 月价格基本保持稳定, 未出现大幅波动。交期较短, 能快速响应市场需求。在中低端市场需求较为旺盛, 但市场竞争激烈, 存在内卷现象。

2) 市场趋势

- **价格趋势:** 车规 MCU 依赖的 DRAM (如 LPDDR4X) 因原厂停产导致供需失衡价格暴涨, 预计将间接推高 2025 年三季度车规 MCU 成本。
- **国产替代:** 中国 MCU 自给率虽不足 15% (车规级 <5%) , 但在加速提升, 本土厂商快速切入家电、物联网等领域, 同时积极攻关车规等高端应用, 填补进口缺口。

信息来源

- [1] Anadolu Ajansi. "US, China to discuss tariff deadline extension in Stockholm next week", 2025.
- [2] AP News. "Trump says a China trip is 'not too distant' as trade tensions ease", 2025.
- [3] AlInvest. "NVIDIA's Strategic Reentry into China's AI Market: A Geopolitical Shift with Market Implications", 2025.
- [4] Associated Press. "Trump says a China trip is 'not too distant' as trade tensions ease", 2025.
- [5] Built In. "Trump Lifted the AI Chip Ban on China, Clearing Nvidia and AMD to Resume Sales", 2025.
- [6] Channel NewsAsia. "As the US cuts trade deals across Asia, how is China feeling the heat?", 2025.
- [7] The Hindu. "'China trip not too distant': Trump to soon meet Xi Jinping as trade tensions ease", 2025.
- [8] Holland & Knight. "Reciprocal Tariff Update: State of Bilateral Negotiations", 2025.
- [9] Investopedia. "China Tariff Deadline Could Be Pushed Back, Top Trump Official Says", 2025.
- [10] SLKORIC. "U.S. Lifts EDA Export Restrictions to China: Semiconductor Industry Sees Relief, but Self-Reliance Remains a Long-Term Challenge", 2025.
- [11] Tech in Asia. "US lifts chip design software export curbs to China", 2025.
- [12] Tech Wire Asia. "Nvidia AI Chip Export Restrictions Lifted", 2025.
- [13] The Straits Times. "US Lifts Curbs for Chip Design Software", 2025.
- [14] The White House. "Fact Sheet: President Donald J. Trump Continues Enforcement of Reciprocal Tariffs and Announces New Tariff Rates", 2025.
- [15] Times of India. "'Always, zero tariffs to...': Donald Trump says US willing to lower tariff rates for major countries - this condition needs to be fulfilled", 2025.
- [16] Micron. "Micron Stock Hits Recent Low Amid HBM Price War," 2025.
- [17] NVIDIA & AMD. "US Eases AI Chip Export Restrictions, Easing China's AI

Compute Shortage," 2025.

[18] Broadcom. "Broadcom Stock Falls on VMware Maintenance and Partner Plan Announcement," 2025.

[19] 德州仪器 (TI) . "下调 2025 财年 Q3 营收指引, 盘后股价暴跌逾 11%", 德州仪器官方新闻稿, 2025.

[20] 台积电. "台积电 Q2 净利润同比大增 61%, 2nm 工艺 2025H2 量产, 月产能 2026 年扩至 10 万片," 2025.

[21] 微芯科技. "微芯科技与台达电子签署 SiC 合作协议," 2025.

[22] 瑞萨电子. "瑞萨电子推出新型 650V/1200V SiC 肖特基二极管," 2025.

[23] 亚德诺半导体 (ADI) . "ADI 牵头成立 OpenGMSL 车载连接开放联盟," 2025.

[24] Marvell Technology. "Marvell 与台积电合作开发 3nm 以下 AI 定制 ASIC 与硅光子技术," 2025.

[25] SK hynix. "SK 海力士 2025 年 Q1 DRAM 销量首超三星, 发布 HBM4/HBM4E 计划," 2025.

[26] 三星电子. "三星电子突破第六代 DRAM 良率, 计划下半年量产 HBM4," 2025.

[27] 英特尔连续六个季度亏损创 35 年最长纪录: 裁员 15%, 取消德国及波兰芯片厂建设计划, 澎湃新闻

[28] 华为发布盘古大模型 5.5 技术突破加速人工智能重塑产业, 央视新闻

[29] 特斯拉中国大陆首个电网侧储能电站一期项目预计今年建成, 界面新闻

[30] 布局“厂中厂”模式 宁德时代电池在问界超级工厂投产, 中国质量新闻网

[31] 中国折叠屏手机行业产业链、出货量及企业市场份额分析, 智研咨询

[32] 苹果沙特官方线上商店启动, 该地区首家零售店明年开业, IT 之家

[33] 宇树科技开启上市辅导, 人形机器人第一股呼之欲出, 新浪财经

[34] 共话中国经济新机遇 | 专访: 中国产业链供应链增强跨国企业在华深耕信心——访施耐德电气全球执行副总裁尹正, 央视网

[35] 25 亿欧元! 大众汽车再投合肥, 选址中国

[36] 鄱阳湖智算中心基本建成 300P 算力设施, 九江鄱阳湖生态科技城

[37] 骨科机器人市场扔出“王炸”: 12 亿收购背后的技术野心

[38] 罕见! DDR4 存储芯片价格跳涨, 部分型号已与 DDR5 产品“倒挂”

[39] 2025 年 6 月创芯指数分析报告—存储器市场活跃, DDR4 与 NOR 闪存大幅升温, IC 交易网

- [40] NAND Flash Q3 涨价成定局 部分产品预估涨幅超过 15%，科创板日报
- [41] 美国在售显卡全部高于 MSRP 起售价！芯语
- [42] 中金 2025 下半年展望 | 消费电子：AI 重构创新边界
- [43] AI 芯片市场的规模到 2028 年将超过 5000 亿美元，科创板日报
- [44] SK 海力士已向英伟达小批量供应 HBM4，芯智讯
- [45] NVIDIA GPU 详细对比：B200、H200、H100、A100、H800、A800、H20
- [46] 6 月新能源汽车销量出炉 多家车企创新高，中国汽车报
- [47] 车用 MCU 芯片还要“缺”多久？中国电子报

免责声明

安芯易电子商务（深圳）有限公司(下称“安芯易公司”)所发布的月度报告由安芯易公司市场部基于现已公开的资料、信息、研究报告等进行整理编制而成。

本报告所载的资料、意见及推测仅反映安芯易公司在报告发布当期的判断、观点，仅供学习参考之用，不构成对所述产品的出价、征价、要约或要约邀请，不构成任何合同或承诺的基础，不构成买卖任何投资工具或者达成任何交易的推荐，亦不构成任何投资、采购及其他应用建议和指导，对任何因直接或间接使用本报告涉及的信息和内容或者据此进行交易、投资所造成的一切后果或损失，安芯易公司不承担任何法律责任。因此，读者在阅读本报告时应保持警惕，并进行独立的判断和分析。

安芯易公司对本报告中所引用的资料、研究报告所涉及的或从第三方媒体获得的信息及数据的真实性、准确性、完整性和及时性不作任何明示或默示的保证。所发布的信息、观点以及数据有可能因发布日之后的情势或其他因素的变更而不再准确或失效，但安芯易公司不承担更新不准确或过时的信息、观点以及数据的义务，在对相关信息进行变更或更新时亦不会另行通知。

该报告版权归安芯易公司及相关内容提供方所有，未经授权，任何人不得以任何方式转载、修改、翻版、分发、复制、发表。

安芯易电子商务（深圳）有限公司

2025 年 7 月



安芯易隶属于Ample Solutions集团,成立于2008年,在全球拥有8个办公室,专注于为全球电子制造业客户提供元器件全球采购及供应链服务。我们始终秉持“专注、专业、坚韧、谦卑”的核心价值观,为客户提供卓越服务,助力客户成功。

我们拥有100+资深采购专家,并与来自全球的10000+供应商建立合作,致力于以更快的速度,更低的成本,为客户解决元器件供应链问题。

在深圳和香港,我们建立了两个高标准品质控制中心,严格遵循国际品质控制体系。从供应商管理到品质检测,全方位地防范风险,确保客户的元器件供应链安全和稳定。



洞察行情 精准决策

